证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2026-053

有研半导体硅材料股份公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”、“有研硅”）拟以发行股份及支付现金的方式向中国有研科技集团有限公司、德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买山东有研艾斯半导体材料有限公司（以下简称“山东有研艾斯”）合计 71.89%的股权；同时，公司拟以发行股份的方式向德州经济技术开发区景泰投资有限公司购买山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”）14.98%的股权。收购上述股权将同步募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，山东有研艾斯、山东有研半导体均将成为公司的全资子公司。

经公司与有关各方的初步核实和论证，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。本次交易不会导致公司控制权发生变化。

二、本次重大资产重组的进展情况

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：有研硅，证券代码：688432）自 2026 年 8 月 31 日开市起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《有研硅关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-037）。

停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于 2026 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研硅关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2026-038）。

2026 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研硅发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《有研硅第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-040）等相关公告。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：有研硅，证券代码：688432）于 2026 年 9 月 14 日开市起复牌。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研硅关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般性风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2026-039）。

2026 年 10 月 12 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研硅关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-043），对本次交易进展情况进行了说明。

截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易所涉及的审计、评估等工作正在有序进行中。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定履行后续审议程序与信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研硅发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

公司将继续严格按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年 11 月 12 日